

ハードウェアセキュリティフォーラム 2016 【開催案内】

【概要】

日時：平成 28 年 12 月 3 日（土）10:00-17:00

会場：武蔵大学・50 周年記念ホール（8 号館 8 階）

東京都練馬区豊玉上 1-26-1

最寄り駅：西武池袋線 江古田駅

会場案内図 URL：<http://www.musashi.ac.jp/annai/campus/ekoda.html>

主催：社団法人電子情報通信学会・ハードウェアセキュリティ時限研究専門委員会

参加費：3000 円（当日受付にてお支払い下さい。領収書発行可）

参加登録：電子メール（hws-forum16@mail.ieice.org）にて事前にご連絡下さい。

ご氏名、ご所属、メールアドレス、懇親会の参加（有り・無し）

【プログラム委員】

松本勉（横国大）、永田真（神戸大）、池田誠（東大）、三浦典之（神戸大）、

国井裕樹（セコム）、鈴木英明（富士通セミコンダクタ）、山本弘毅（ソニーLSI デザイン）

【プログラム】（時間は暫定的なもので講演数に応じて多少変動いたします）

○ハードウェアセキュリティ(HWS)時限研究専門委員会の紹介（10:00～10:15）

○IoTを支えるハードウェアセキュリティと計測セキュリティ（10:15～11:00）

横浜国立大学・松本勉

○ハードウェアセキュリティにおける最近の研究動向（11:00～12:20）（13:40～15:40）

HWS 分野の著名な国際会議の紹介、そこでの日本発表者を招き、研究アクティビティを紹介する。

1. CHES の紹介と日本からの発表

東北大学・上野嶺、本間尚文

2. RFID のハードウェアセキュリティについて

日立製作所・三上修吾

3. IEEE SSCS (ISSCC, VLSI symposium, A-SSCC, ESSCIRC)における動向

東京大学・池田誠

4. チップ・パッケージ・ボードレベルの物理攻撃対策回路技術

神戸大学・三浦典之、永田真

その他、講演依頼継続中

○ハードウェアセキュリティ分野の研究紹介（15:40～17:00）

口頭発表またはポスター発表

※ご発表申込は下記の情報をお寄せ下さい。（締切：2016 年 11 月 21 日）

<http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-HWS>

題目、著者、所属、アブストラクト（100 字程度、プログラムに公開します。）

講演種別（口頭 or ポスター）の希望

他の国際学会等で既発表の内容の場合、その情報もご連絡下さい。

※発表申込多数の場合は、受付順に開催主催者にて選定いたします。

★終了後、懇親会を開催します。参加費 1000 円（領収書発行可）